

Dell EMC PowerEdge MX740c

技术规格

注意、小心和警告

 **注:** “注意” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告:** “警告” 表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。


章 1: PowerEdge MX740c 底座概览	5
系统的正面视图.....	6
系统内部.....	6
找到您的系统的服务标签.....	7
系统信息标签.....	8
章 2: 技术规格	11
系统尺寸.....	11
系统重量.....	12
处理器规格.....	12
英特尔快速帮助技术.....	12
支持的操作系统.....	12
系统电池规格.....	12
内存规格.....	13
硬盘驱动器.....	13
夹层卡和小型夹层插槽规格.....	13
存储控制器规格.....	14
端口和连接器规格.....	14
USB 端口.....	14
内部双 SD 模块.....	14
Micro SD vFlash 连接器.....	14
视频规格.....	14
环境规格.....	14
微粒和气体污染规格.....	15
标准操作温度.....	16
扩展操作温度.....	16
散热.....	17
章 3: 系统诊断程序和指示灯代码	18
电源按钮 LED.....	18
驱动器指示灯代码.....	18
系统运行状况和系统 ID 指示灯代码.....	19
系统诊断程序.....	19
戴尔嵌入式系统诊断程序.....	20
章 4: 说明文件资源	21
章 5: 获取帮助	23
联系 Dell EMC.....	23
说明文件反馈.....	23
通过使用 QRL 访问系统信息.....	23
PowerEdge MX740c 系统的快速资源定位符.....	24
通过 SupportAssist 接收自动支持.....	24

回收或停售服务信息.....24

PowerEdge MX740c 底座概览

Dell EMC PowerEdge MX740c 是单宽计算底座，支持：

- 多达两个英特尔至强可扩展处理器。
- 多达 24 个 DIMM 插槽。
- 多达六个 2.5 英寸 SAS、SATA (HDD/SSD) 或 NVMe 驱动器。

 **注：** SAS、NVMe、SATA HDD 和 SSD 的所有实例在本说明文件中都称为驱动器，除非另有说明。

主题：

- [系统的正面视图](#)
- [系统内部](#)
- [找到您的系统的服务标签](#)
- [系统信息标签](#)

系统的正面视图

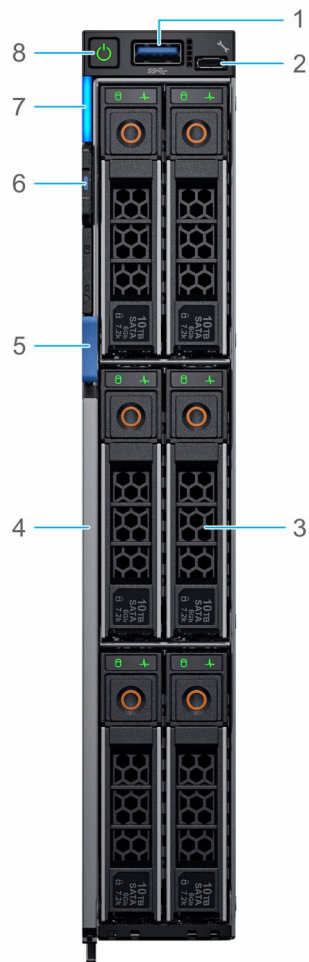


图 1: 6 驱动器配置的前视图

1. USB 3.0 端口
2. iDRAC Direct 端口
3. 驱动器
4. 释放手柄
5. 释放手柄按钮
6. 信息标签
7. 系统运行状况和系统 ID 指示灯
8. 电源按钮

有关端口的更多信息，请参阅[技术规格](#)。

系统内部

注: 可热插拔的组件触点为橙色，不可热插拔的组件触点为蓝色。

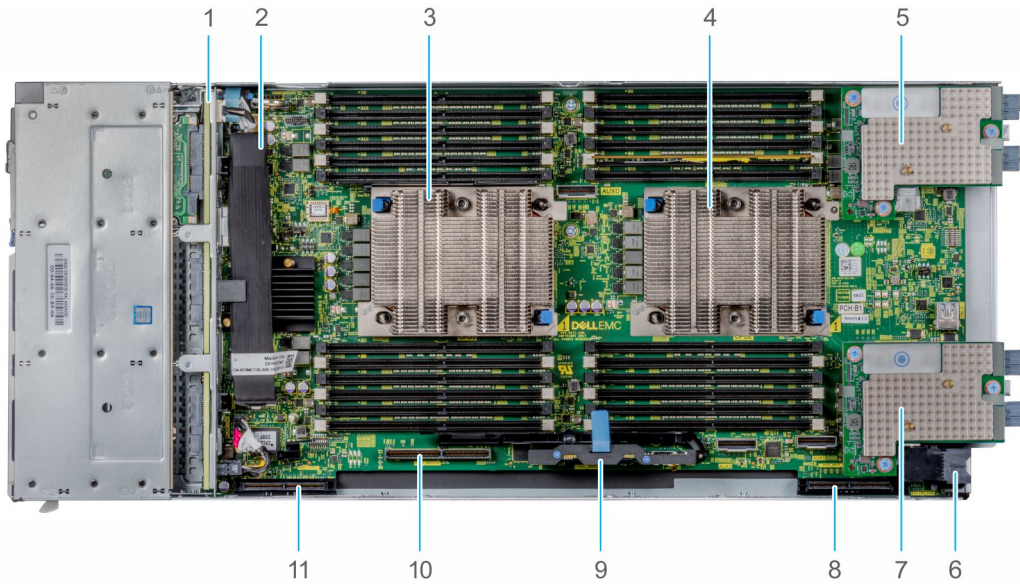


图 2: 系统内部

1. 背板
2. 底板电缆
3. 处理器 1 (散热器)
4. 处理器 2 (散热器)
5. 夹层卡 A1
6. 电源连接器
7. 夹层卡 B1
8. 小型夹层卡连接器
9. iDRAC 卡
10. BOSS 连接器
11. PERC 连接器

找到您的系统的服务标签

System Information (系统信息) 选项卡中包含系统的唯一快速服务代码和服务标签。此信息由 Dell EMC 用于识别系统配置、保留期以及将支持呼叫转接给合适的人员。System Information (系统信息) 选项卡上的快速资源定位器 (QRL) 标签链接到一个 Web 页面，其中显示了确切的出厂配置和购买的特定保修。

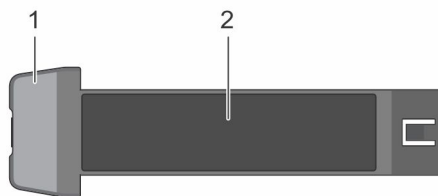


图 3: 找到您的系统服务标签

1. 信息标签
2. 服务标签

系统信息标签

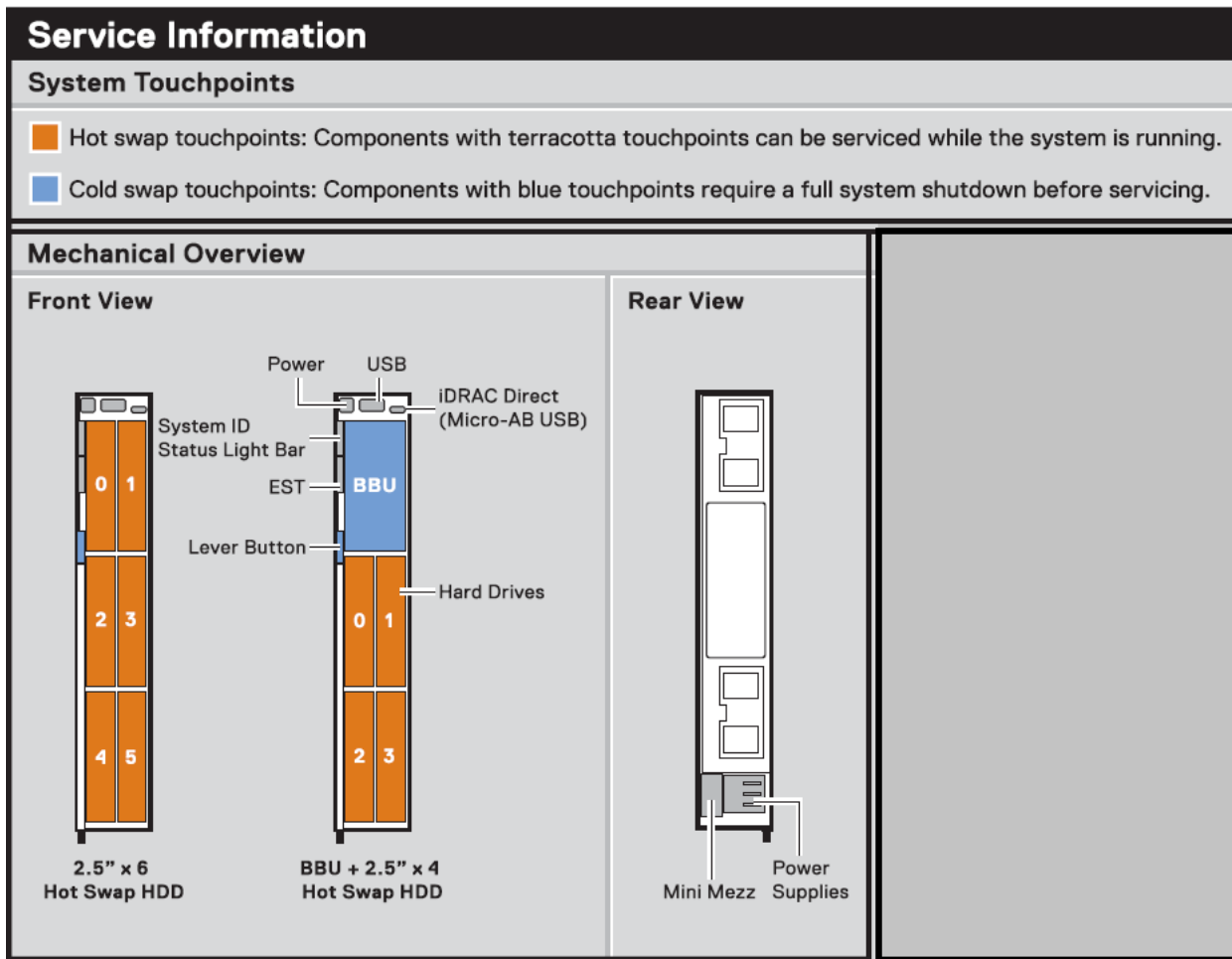


图 4: 机械概览

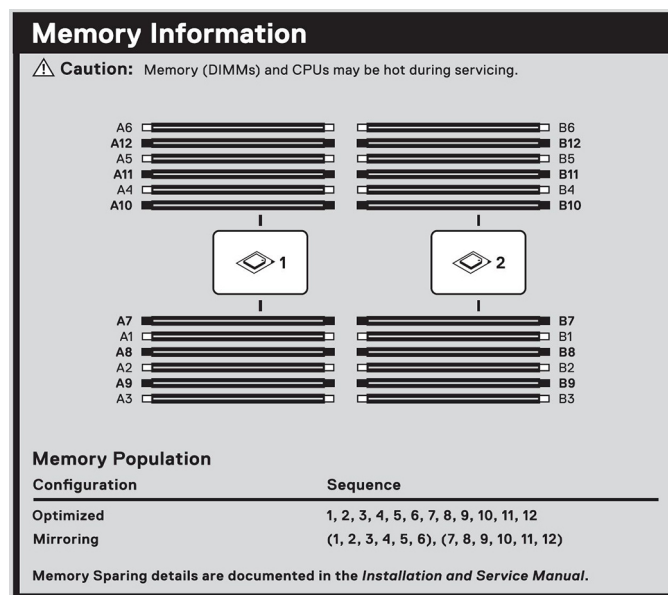


图 5: 内存信息

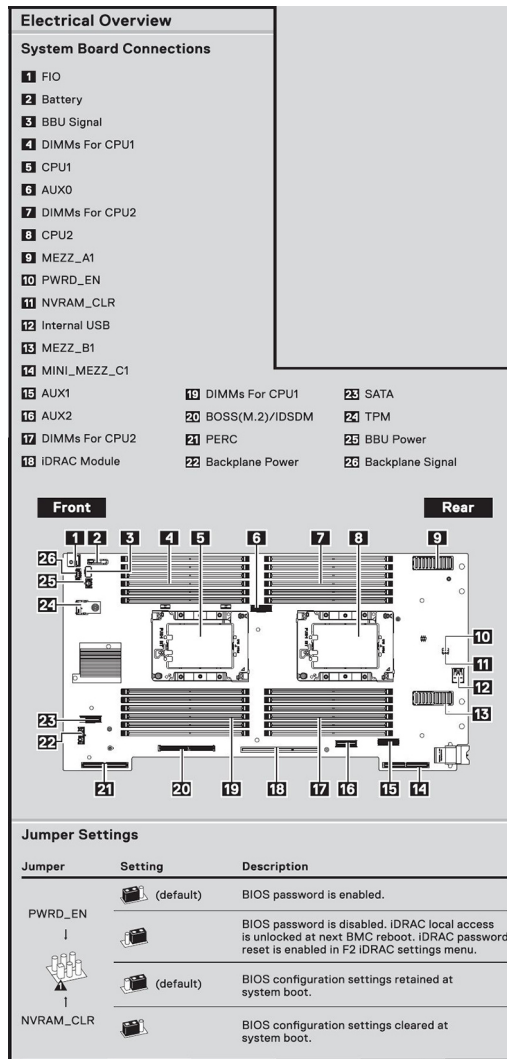


图 6: 系统板

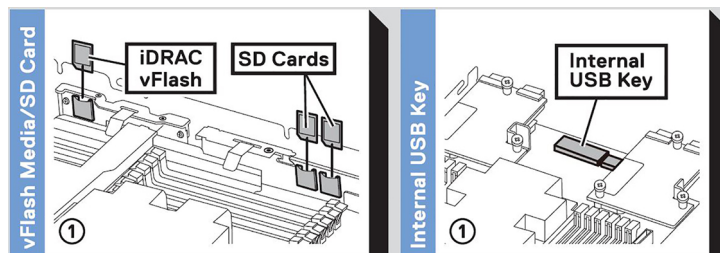


图 7: 卸下 iDSDM 和内部 USB 存储盘 (可选)

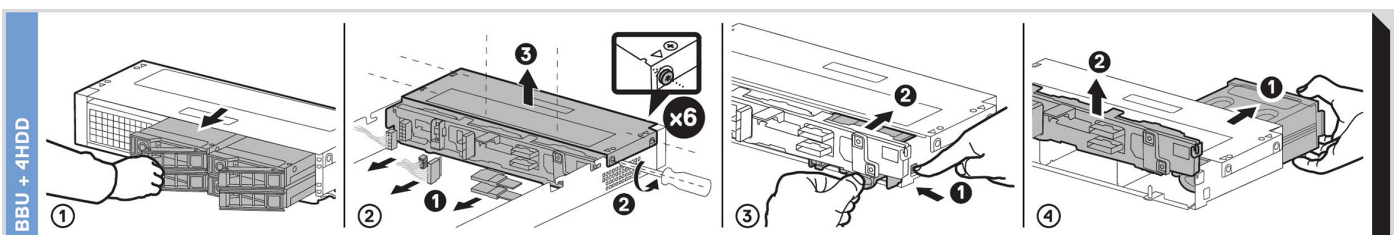


图 8: 卸下 BBU 模块和驱动器固定框架

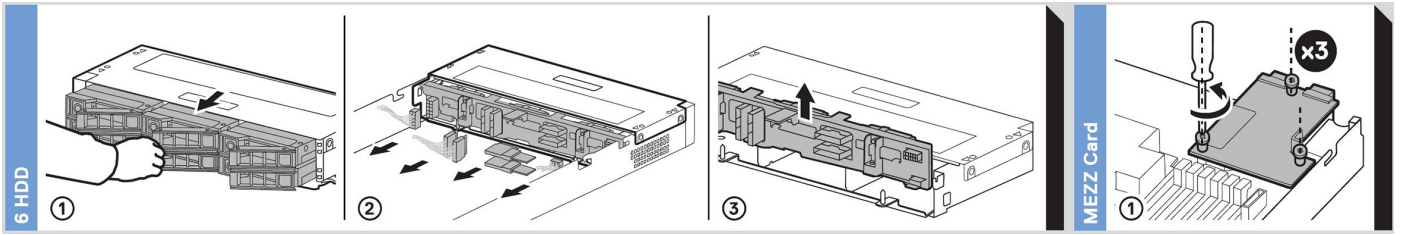


图 9: 卸下底板和夹层卡

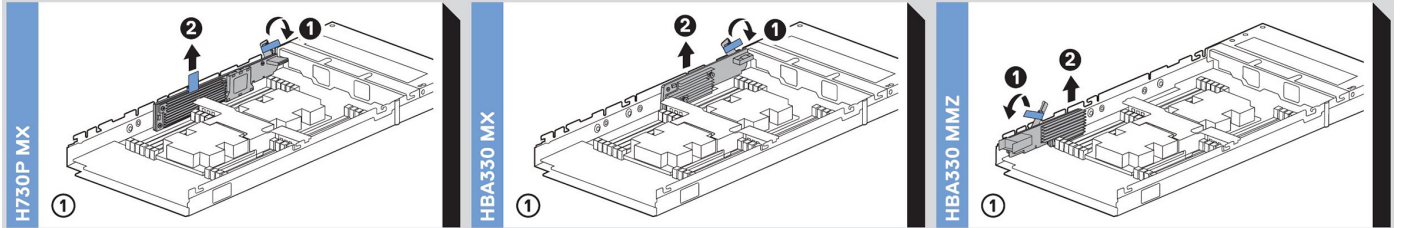


图 10: 卸下 PERC 卡和小型夹层卡

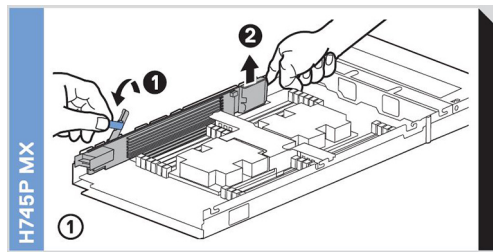


图 11: 卸下 Jumbo PERC 卡

技术规格

本节概述了系统的技术规格和环境规格。

主题：

- 系统尺寸
- 系统重量
- 处理器规格
- 支持的操作系统
- 系统电池规格
- 内存规格
- 硬盘驱动器
- 夹层卡和小型夹层插槽规格
- 存储控制器规格
- 端口和连接器规格
- 视频规格
- 环境规格

系统尺寸

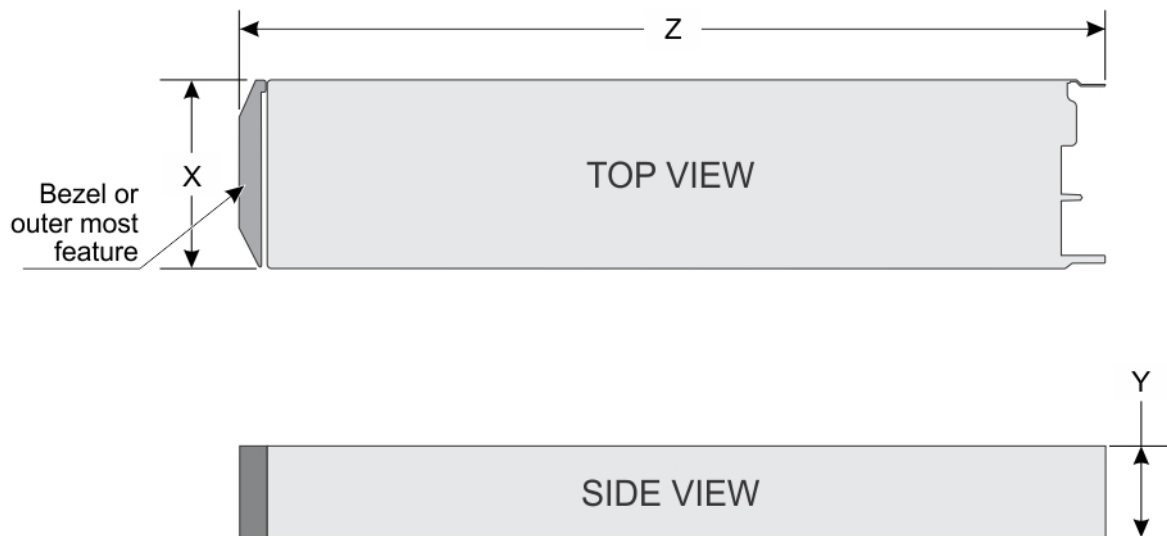


图 12: 系统尺寸

表. 1: PowerEdge MX740c 系统的尺寸

系统	X	Y	Z (合上手柄)。
Dell EMC PowerEdge MX740c	250.2 毫米 (9.85 英寸)	42.15 毫米 (1.65 英寸)	620.35 毫米 (24.42 英寸)

系统重量

表. 2: 系统重量

系统	最大重量
Dell EMC PowerEdge MX740c	9.5 千克 (20.94 磅)

处理器规格

Dell EMC PowerEdge MX740c 系统支持多达两个英特尔至强可扩展处理器，每个处理器多达 28 个内核。

处理器功率和散热器尺寸

表. 3: 处理器功率和散热器尺寸

处理器配置	处理器类型	散热器宽度	每个处理器的最大 DIMM 数	DIMM、RAS 数量
所有	高达 205 W	90 毫米	12	12

英特尔快速帮助技术

Dell EMC PowerEdge MX740c 上的英特尔®快速帮助技术支持芯片组集成，并且通过可选的许可证启用。通过 iDRAC 在底座上启用许可证文件。

有关 iDRAC 的更多信息，请参阅 *Dell Integrated Remote Access Controller User's Guide (戴尔集成远程访问控制器用户指南)*，网址：www.dell.com/poweredgemanuals

有关英特尔® QAT 的驱动程序、说明文件和白皮书的更多信息，请参阅 <https://01.org/intel-quickassist-technology>。

支持的操作系统

Dell EMC PowerEdge MX740c 底座支持以下操作系统：

- Citrix XenServer
- 带 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SuSE Linux Enterprise Server
- Ubuntu
- VMWare ESXi

有关特定版本和增补内容的更多信息，请转至 <https://www.dell.com/ossupport>。

系统电池规格

Dell EMC PowerEdge MX740c 系统支持 CR 2032 3.0-V Nickel-Plated 锂币系统电池。

内存规格

表. 4: 内存规格

DIMM 类型	DIMM 列	DIMM 容量	单处理器		双处理器	
			最小 RAM	最大 RAM	最小 RAM	最大 RAM
LRDIMM	八列	128 GB	128 GB	1536 GB	256 GB	3072 GB
	四列	64 GB	64 GB	768 GB	128 GB	1536 GB
RDIMM	单列	8 GB	8 GB	96 GB	16 GB	192 GB
	双列	16 GB	16 GB	192 GB	32 GB	384 GB
		32 GB	32 GB	384 GB	64 GB	768 GB
	64 GB	64 GB	768 GB	128 GB	1536 GB	
NVDIMM-N	单列	16 GB	在单处理器配置下不受支持	在单处理器配置下不受支持	RDIMM : 192 GB	RDIMM : 384 GB
					NVDIMM-N : 16 GB	NVDIMM-N : 192 GB
DCPMM	不适用	128 GB	RDIMM : 64 GB	RDIMM : 384 GB	RDIMM : 128 GB	LRDIMM : 1536 GB
			DCPMM : 128 GB	DCPMM : 128 GB	DCPMM : 1536 GB	DCPMM : 1536 GB
	不适用	256 GB	不适用	不适用	RDIMM : 192 GB	LRDIMM : 1536 GB
			不适用	不适用	DCPMM : 2048 GB	DCPMM : 3072 GB
	不适用	512 GB	不适用	不适用	RDIMM : 384 GB	RDIMM : 1536 GB
			不适用	不适用	DCPMM : 4096 GB	DCPMM : 6144 GB

- ① 注: 8 GB RDIMM 和 NVDIMM-N 不得混用。
- ① 注: 64 GB LRDIMM 和 128 GB LRDIMM 不得混用。
- ① 注: 支持 NVDIMM-N 的任何配置都需要最少两个处理器。
- ① 注: DCPMM 可以与 RDIMM 和 LRDIMM 混用。
- ① 注: 不支持在插槽内或跨插槽混用英特尔 DCPMM 运行模式 (App Direct、内存模式)。

硬盘驱动器

Dell EMC PowerEdge MX740c 系统支持多达六个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA HDD、SSD 或 PCIe NVMe 驱动器。驱动器在热插拔驱动器托架中提供，并且这些驱动器通过底板连接到系统板或 RAID 控制器。

- ① 注: 需要双处理器配置以支持 NVMe 驱动器。

夹层卡和小型夹层插槽规格

Dell EMC PowerEdge MX740c 支持：

- 一个 x16 PCIe 3.0 用于小型夹层卡 - 连接到处理器 2。
- 两个 x16 PCIe 3.0 用于夹层卡 - 夹层卡 A1 连接到处理器 1，夹层卡 B1 连接到处理器 2。

存储控制器规格

Dell EMC PowerEdge MX740c 系统支持 PowerEdge RAID 控制器 (PERC) HBA330 MX、HBA330、H730P MX、H745P MX、H730P、H745P、S140 (SATA 和 NVMe 驱动器)、HBA330 MMZ (小型夹层卡)、光纤通道 HBA (在小型夹层卡架构 C 插槽) 中以及引导优化服务器存储 (BOSS M.2)。

端口和连接器规格

USB 端口

Dell EMC PowerEdge MX740c 系统支持：

- 系统正面一个 USB 3.0 兼容端口
- 系统正面一个 micro USB/iDRAC Direct USB 2.0 兼容端口
- 一个 USB 3.0 兼容内部端口

注：系统正面的 Micro USB 2.0 兼容端口只可以用作 iDRAC Direct 管理端口。

内部双 SD 模块

Dell EMC PowerEdge MX740c 系统支持可选的内部双 SD 模块 (IDSDM) 模块。在第 14 代 PowerEdge 服务器中，IDSDM 模块支持两个 micro SD 卡。IDSDM 的 Micro SD 卡容量是 16、32、64 GB。

注：IDSDM 模块上有两个 DIP 开关用于写保护。

注：一个 IDSDM 卡插槽为冗余专用。

注：建议使用与 IDSDM 配置的系统关联的戴尔品牌 MicroSD 卡。

Micro SD vFlash 连接器

Dell EMC PowerEdge MX740c 系统在 iDRAC 模块上支持一个专用 micro SD 卡以供未来支持 vFlash。建议使用与 IDSDM 模块关联的戴尔品牌 MicroSD 卡。

视频规格

表. 5: 视频规格

类型	说明
视频类型	与 iDRAC 集成的 Matrox G200 显卡控制器
视频内存	与 iDRAC 应用程序内存共享的 4 Gb DDR4

环境规格

注：有关环境认证的其他信息，请参阅手册和说明文件中的“产品环境数据表”，网址：www.dell.com/poweredgemanuals

表. 6: 温度规格

温度	规格
存储	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)

表. 6: 温度规格 (续)

温度	规格
连续工作 (在低于海拔 950 米或 3117 英尺时)	在设备无直接光照的情况下, 10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)。
最高温度梯度 (操作和存储)	20°C/h (68°F/h)

表. 7: 相对湿度规格

相对湿度	规格
存储	最大露点为 33°C (91°F) 时, 相对湿度为 5% 至 95%。空气必须始终是非冷凝状态。
使用时	相对湿度为 10% 至 80%, 最大露点为 29 °C (84.2 °F)。

表. 8: 最大振动规格

最大振动	规格
使用时	5 Hz 至 350 Hz 时, 0.26 G _{rms} (所有操作方向)。
存储	10 Hz 至 500 Hz 时, 1.87 G _{rms} , 可持续 15 分钟 (所有六面被测)。

表. 9: 最大撞击规格

最大撞击	规格
使用时	在 x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续六个 6 G 的撞击脉冲, 最长可持续 11 毫秒。
存储	x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续六个 71 G 的撞击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲), 最长可持续 2 毫秒。

表. 10: 最大海拔高度规格

最大海拔高度	规格
使用时	3048 米 (10,000 英尺)
存储	12,000 米 (39,370 英尺)

表. 11: 工作温度降额规格

工作温度降额	规格
高达 35 °C (95 °F)	最高温度在 950 米 (3,117 英尺) 以上时按 1 °C/300 米 (1 °F/547 英尺) 降低。
35 °C 至 40 °C (95 °F 至 104 °F)	最高温度在 950 米 (3,117 英尺) 以上时按 1 °C/175 米 (1 °F/319 英尺) 降低。
40 °C 至 45 °C (104 °F 至 113 °F)	最高温度在 950 米 (3,117 英尺) 以上时按 1 °C/125 米 (1 °F/228 英尺) 降低。

微粒和气体污染规格

下表定义了限制范围, 帮助避免微粒和气体污染导致任何设备损坏或故障。如果颗粒或气体污染级别超过指定的限制范围并导致设备损坏或发生故障, 您可能需要改善环境条件。整改环境条件是客户的责任。

表. 12: 微粒污染规格

微粒污染	规格
空气过滤	按照 ISO 14644-1 第 8 类定义的拥有 95% 置信上限的数据中心空气过滤。

表. 12: 微粒污染规格 (续)

微粒污染	规格
	<p>①注: 此情况仅适用于数据中心环境。空气过滤要求不适用于旨在数据中心之外 (诸如办公室或工厂车间等环境) 使用的 IT 设备。</p> <p>①注: 进入数据中心的空气必须拥有 MERV11 或 MERV13 过滤。</p>
导电灰尘	<p>空气中不得含有导电灰尘、锌晶须或其他导电颗粒。</p> <p>①注: 此条件适用于数据中心和非数据中心环境。</p>
腐蚀性灰尘	<ul style="list-style-type: none"> 空气中不得含有腐蚀性灰尘。 空气中的残留灰尘的潮解点必须小于 60% 相对湿度。 <p>①注: 此条件适用于数据中心和非数据中心环境。</p>

表. 13: 气体污染规格

气体污染	规格
铜片腐蚀率	<300 Å/月, 按照 ANSI/ISA71.04-1985 定义的 G1 类标准。
银片腐蚀率	<200 Å/月, 按照 AHSRAE TC9.9 定义的标准。

①注: 腐蚀性污染物最大浓度值在小于等于 50% 相对湿度下测量。

标准操作温度

表. 14: 标准操作温度规格

标准操作温度	规格
连续工作 (在低于海拔 950 米或 3117 英尺时)	在设备无直接光照的情况下, 10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)。
湿度百分比范围	最大露点为 29 °C (84.2 °F) 时, 相对湿度为 10% 至 80%。

扩展操作温度

表. 15: 扩展操作温度规格

扩展操作温度	规格
连续工作	<p>5°C 至 40°C, 相对湿度为 5% 至 85%, 露点为 29°C</p> <p>①注: 在标准操作温度范围 10 °C–35 °C 之外, 系统可以在低至 5 °C、高至 40 °C 的温度下连续工作。</p> <p>若温度在 35°C 至 40°C 之间, 在 950 米以上时, 每上升 175 米, 最大允许干球温度将下降 1°C (每 319 英尺下降 1°F)。</p>
小于或等于每年操作时间的 1%	<p>-5°C 至 45°C, 相对湿度为 5% 至 90%, 露点为 29°C</p> <p>①注: 除了标准操作温度范围 (10°C–35°C) 之外, 系统能在最低 -5°C 或最高 45°C 的温度下运行, 运行时间长达每年操作时间的 1%。</p> <p>若温度在 40°C–45°C 之间, 在 950 米以上时, 每上升 125 米, 最大允许温度将下降 1°C (每 228 英尺下降 1°F)。</p>

①注: 在扩展温度范围下操作时, 系统性能将会受到影响。

①注: 在扩展温度范围内操作时, LCD 面板和系统事件日志中可能会报告环境温度警告。

扩展操作温度限制

1. 请勿在 5°C 以下执行冷启动。
2. 指定的操作温度适用的最高海拔高度为 3050 米 (10,000 英尺) 。
3. 较低的内核数处理器 [Gold 6146、6144、6134、6128、5222、5217、5122] 或更高功率的处理器 [热设计功耗 (TDP)>140 W] 不受支持。
4. 不支持非戴尔认证的外围设备卡或超过 30 W 的外围设备卡。
5. 不支持 PCIe SSD。
6. NVDIMM 不受支持。
7. DCPMM 不受支持。

散热

PowerEdge 服务器采用一系列全面的传感器，可自动跟踪散热活动以帮助调整温度，从而降低服务器噪音和功耗。Mx740c 中的传感器与调整风扇速度的机箱管理服务模块进行交互。用于为 Mx740c 散热的所有风扇都包含在 MX7000 机箱中。

PowerEdge Mx740c 的散热管理可提供较高的性能，从而在从 10 °C 到 35 °C (50 °F 到 95 °F) 的一系列环境温度以及扩展环境温度范围 (请参阅环境温度) 下以最低的风扇速度为组件提供合适的冷却能力。您将受益于更低的风扇功耗 (更低的服务器系统功耗) 和更高的声音多样性。

有关散热的详细信息，请咨询 MX7000 技术指南。

表. 16: 散热限制列表

环境支持	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C~45 °C 扩展操作温度
CPU CLX 刷新 205 W CPU (6242R、6246R、6248R、6258R) 配置。	无限制	无限制 (散热设计功率 (TDP) > 205 W 的处理器 的建议操作温度低于 25°C)	不支持	不支持
DIMM	无限制	无限制	无限制	不支持 NVDIMM
驱动器	无限制	无限制	无限制	不支持 NVMe (PCIe SSD)
夹层卡	无限制	无限制	无限制	不支持功率为 30 W 以上的夹层卡

系统诊断程序和指示灯代码

系统前面板上的诊断指示灯在系统启动期间显示系统状态。

主题：

- 电源按钮 LED
- 驱动器指示灯代码
- 系统运行状况和系统 ID 指示灯代码
- 系统诊断程序

电源按钮 LED

电源按钮 LED 位于系统的前面板上。



图 13: 电源按钮 LED

表. 17: 电源按钮 LED

电源按钮 LED 指示灯代码	状态
Off (关闭)	系统未运行，无论电源设备是否可用。
On (打开)	系统正在运行、一个或多个非备用电源设备处于活动状态。
缓慢闪烁	系统正在按顺序执行开机并且 iDRAC 仍在引导。

驱动器指示灯代码

驱动器托架上的 LED 表示每个驱动器的状态。系统中的每个驱动器托架都有两个 LED：活动 LED（绿色）和状态 LED（双色、绿色/琥珀色）。每当访问驱动器时，活动 LED 会闪烁。



图 14: 驱动器上的驱动器指示灯和中间驱动器托架背板

1. 驱动器活动 LED 指示灯
2. 驱动器状态 LED 指示灯

3. 驱动器容量标签

注: 如果驱动器处于高级主机控制器接口 (AHCI) 模式, 则 LED 指示灯不会亮起。

表. 18: 驱动器指示灯代码

驱动器状态指示灯代码	状态
每秒呈绿色闪烁两次	识别驱动器或准备卸下。
Off (关闭)	驱动器做好移除准备。 注: 在系统开机之后所有硬盘驱动器都初始化之前, 驱动器状态指示灯会一直保持熄灭。此时, 驱动器不能进行插入或卸下操作。
闪烁绿色、琥珀色, 然后熄灭	预测的驱动器故障
每秒闪烁琥珀色光四次	驱动器故障
缓慢闪烁绿光	正在重建驱动器
呈绿色稳定亮起	驱动器联机
呈绿色闪烁三秒, 呈琥珀色闪烁三秒, 然后在六秒钟后熄灭	重建已停止

系统运行状况和系统 ID 指示灯代码

系统运行状况和系统 ID 指示灯位于系统左侧控制面板。



图 15: 系统运行状况和系统 ID 指示灯

表. 19: 系统运行状况和系统 ID 指示灯代码

系统运行状况和系统 ID 指示灯代码	状态
呈蓝色常亮	表示系统处于开启状态, 系统运行良好, 和系统 ID 模式处于不活动状态。按 MX7000 左侧控制面板的系统运行状况和系统 ID 按钮可切换到系统 ID 模式。
呈蓝色闪烁	表示系统 ID 模式处于活动状态。按 MX7000 左侧控制面板的系统运行状况和系统 ID 按钮可切换到系统运行状况模式。
呈琥珀色稳定亮起	表示系统处于故障安全模式。
呈琥珀色闪烁	指示系统正在遇到故障。检查特定错误消息的系统事件日志。有关错误消息的更多信息, 请参阅 <i>Dell Event and Error Messages Reference Guide (戴尔事件和错误消息参考指南)</i> , 网址: www.dell.com/openmanagemanuals 。

系统诊断程序

如果您的系统出现问题, 请在致电戴尔寻求技术帮助之前运行系统诊断程序。运行系统诊断程序旨在检测系统的硬件, 它不需要其他设备, 也不会有数据丢失的风险。如果您无法自行解决问题, 维修和支持人员可以使用诊断程序的检测结果帮助您解决问题。

戴尔嵌入式系统诊断程序

注: 戴尔嵌入式系统诊断程序也称为增强的预引导系统评估 (ePSA) 诊断程序。

嵌入式系统诊断程序为特定设备组或设备提供一组选项，使您可以：

- 自动运行测试或在交互模式下运行
- 重复测试
- 显示或保存测试结果
- 运行全面测试以引入附加测试选项，从而提供有关失败设备的额外信息
- 查看告知您测试是否成功完成的状态消息
- 查看告知您在测试过程中所遇到问题的错误消息

从引导管理器运行嵌入式系统诊断程序

如果您的系统不引导，运行嵌入式系统诊断程序 (ePSA)。

1. 系统引导过程中请按下 F11。
2. 使用上下箭头键选择**系统实用程序 > 启动诊断程序**。
3. 或者，当系统正在引导时，按 F10 键，选择**硬件诊断程序 > 运行硬件诊断程序**。
将显示 **ePSA 预引导系统评估**窗口，列出系统中检测到的所有设备。诊断程序开始在所有检测到的设备上执行测试。

从戴尔生命周期控制器运行嵌入式系统诊断程序

1. 系统引导时按 F10。
2. 选择**硬件诊断**→ **运行硬件诊断程序**。
将显示 **ePSA 预引导系统评估**窗口，列出系统中检测到的所有设备。诊断程序开始在所有检测到的设备上执行测试。

系统诊断程序控制

菜单	说明
配置	显示所有检测到的设备的配置和状态信息。
结果	显示运行的所有测试的结果。
系统运行状况	提供系统性能的当前概况。
事件日志	显示系统上运行的所有检测的结果的时间戳日志。如果至少记录一个事件描述，则显示此选项。

说明文件资源

本节介绍了有关系统说明文件资源的信息。

要查看文档资源表中列出的说明文件表：

- 从 Dell EMC 支持站点：
 1. 单击表中“位置”列下提供的文档链接。
 2. 单击所需的产品或产品版本。
 - ① **注：**要找到产品名称和型号，请参阅您的系统正面。
 3. 在“产品支持”页面上，单击**手册和文档**。
- 使用搜索引擎：
 - 在搜索框中键入文档的名称和版本。

表. 20: 系统其他说明文件资源

任务	说明文件	位置
设置系统	有关将系统安装和固定到机架中的更多信息，请参阅机架解决方案随附的 Rail Installation Guide。 有关设置系统的信息，请参阅系统随附的 Getting Started Guide 说明文件。	www.dell.com/poweredgemanuals
配置系统	有关 iDRAC 的功能、配置和登录 iDRAC，以及远程管理系统的信息，请参阅 Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide。 要了解 Remote Access Controller Admin (RACADM) 子命令和支持的 RACADM 界面的信息，请参阅 RACADM CLI Guide for iDRAC。 有关 Redfish 及其协议、支持的架构以及 iDRAC 中实施的 Redfish 的信息，请参阅 Redfish API Guide。 有关 iDRAC 属性数据库组和对象说明的信息，请参阅 Attribute Registry Guide。 有关英特尔 QuickAssist 技术的信息，请参阅 Integrated Dell Remote Access Controller User' s Guide。	www.dell.com/poweredgemanuals
	有关较早版本的 iDRAC 说明文件的信息，请参阅 iDRAC 文档。 要识别您的系统上可用的 iDRAC 版本，在 iDRAC web 界面，单击 ? > 关于 。	www.dell.com/idracmanuals
	有关安装该操作系统的信息，请参阅操作系统说明文件。	www.dell.com/operatingsystemmanuals

表. 20: 系统其他说明文件资源 (续)

任务	说明文件	位置
	有关更新驱动程序和固件的信息，请参阅本说明文件中的“下载固件和驱动程序的方法”部分。	www.dell.com/support/drivers
管理系统	有关戴尔提供的系统管理软件的信息，请参阅 Dell OpenManage Systems Management Overview Guide。	www.dell.com/poweredge/manuals
	有关安装、使用 OpenManage 以及进行故障处理的信息，请参阅 Dell OpenManage Server Administrator User's Guide。	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Server Administrator
	有关安装、使用 Dell OpenManage Essentials 以及进行故障处理的信息，请参阅 Dell OpenManage Essentials User's Guide。	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Essentials
	有关安装、使用 Dell OpenManage Enterprise 以及进行故障处理的信息，请参阅 Dell OpenManage Essentials User's Guide。	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Enterprise
	有关安装和使用 Dell SupportAssist 的信息，请参阅 Dell EMC SupportAssist Enterprise User's Guide。	https://www.dell.com/serviceabilitytools
	有关合作伙伴计划企业系统管理的信息，请参阅 OpenManage Connections Enterprise Systems Management 说明文件。	www.dell.com/openmanagemanuals
	使用戴尔 PowerEdge RAID 控制器	要了解戴尔 PowerEdge RAID 控制器 (PERC)、软件 RAID 控制器或 BOSS 卡的功能以及部署卡的信息，请参阅存储控制器说明文件。
了解事件和错误消息	有关系统固件和代理（用于监控系统组件）生成的事件和错误消息的信息，请参阅“查找错误代码”。	www.dell.com/qrl
系统故障处理	有关发现和排除 PowerEdge 服务器问题的信息，请参阅 Server Troubleshooting Guide。	www.dell.com/poweredge/manuals

主题：

- [联系 Dell EMC](#)
- [说明文件反馈](#)
- [通过使用 QRL 访问系统信息](#)
- [通过 SupportAssist 接收自动支持](#)
- [回收或停售服务信息](#)

联系 Dell EMC

Dell EMC 提供了几种联机以及电话支持和服务选项。如果没有可用的互联网连接，可在购货发票、装箱单、帐单或 Dell EMC 产品目录上查找联系信息。具体的服务随您所在国家/地区以及产品的不同而不同，某些服务在您所在的地区可能不提供。要就销售、技术帮助或客户服务问题联系 Dell EMC：

1. 转至 www.dell.com/support/home。
2. 从页面右下角的下拉菜单中选择您所在的国家/地区。
3. 对于定制的支持：
 - a. 在**输入您的服务编号**字段中，输入您的系统服务编号。
 - b. 单击**提交**。
此时将显示其中列出各种支持类别的支持页面。
4. 对于一般支持：
 - a. 选择您的产品类别。
 - b. 选择您的产品领域。
 - c. 选择您的产品。
此时将显示其中列出各种支持类别的支持页面。
5. 有关联系 Dell EMC 全球技术支持的详细信息：
 - a. 单击 [全球技术支持](#)。
 - b. 在“联系我们”网页上的**输入您的服务编号**字段中，输入您的系统服务编号。

说明文件反馈

您可以在任何 Dell EMC 说明文件页面上为说明文件打分或写下反馈，然后单击**发送反馈**以发送反馈。

通过使用 QRL 访问系统信息

您可以使用系统正面的信息标签中的快速资源定位符 (QRL)，以访问关于 PowerEdge 系统的信息。

确保您的智能手机或平板电脑扫描仪装有 QR 代码扫描器。

QRL 包括关于您系统的以下信息：

- 指导视频
 - 参考资料，包括安装和维修手册、以及机械概览
 - 您的系统服务编号，以快速访问您的特定硬件配置和保修信息
 - 直接转至戴尔的链接，用于联系技术支持和销售团队
1. 转至 www.dell.com/qrl 并导航至您的特定产品或
 2. 使用智能手机或平板电脑扫描系统上或快速资源定位符部分中特定于型号的快速资源 (QR) 代码。

PowerEdge MX740c 系统的快速资源定位符



图 16: PowerEdge MX740c 系统的快速资源定位符

通过 SupportAssist 接收自动支持

Dell EMC SupportAssist 是可选的 Dell EMC 服务产品，可自动提供适用于您的 Dell EMC 服务器、存储设备和联网设备的技术支持。通过在您的 IT 环境中安装和设置 SupportAssist 应用程序，您可以获得以下优势：

- **自动化问题检测** — SupportAssist 会监测您的 Dell EMC 设备，并以主动和预测方式自动检测硬件问题。
- **自动化案例创建** — 当检测到问题后，SupportAssist 会自动向 Dell EMC 技术支持创建支持案例。
- **自动收集诊断** — SupportAssist 可自动从您的设备收集系统状态信息并将其安全地上传到 Dell EMC。此信息由 Dell EMC 技术支持使用以排除问题。
- **主动联系** — 戴尔技术支持专员将就该支持案例与您联系，帮助您有效解决问题。

可用优势取决于您为设备购买的 Dell EMC 服务权利。有关 SupportAssist 的更多信息，请转至 www.dell.com/supportassist。

回收或停售服务信息

回收和循环利用服务在某些国家和地区提供。如果您想要处理系统组件，请访问 www.dell.com/recyclingworldwide 并选择相关国家/地区。